



**SOLVASI PREFERENSIAL DAN SIFAT DINAMIKA ION Cu<sup>+</sup>  
DALAM LARUTAN AMONIAK 18,6% : STUDI SIMULASI  
DINAMIKA MOLEKULER AB INITIO QUANTUM  
MECHANICAL CHARGE FIELD (QMCF)**

Wahyu Dita Saputri  
15/391207/PPA/05008

**INTISARI**

Solvasi preferensial dan sifat dinamika ion Cu<sup>+</sup> telah dipelajari menggunakan metode simulasi dinamika molekuler QMCF (DM-QMCF). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sifat dinamika dan solvaci preferensial ion Cu<sup>+</sup> terhadap ligan NH<sub>3</sub> dan H<sub>2</sub>O dalam larutan amoniak 18,6%. Metode DM-QMCF membagi dua daerah simulasi, yaitu daerah mekanika kuantum (MK) dan mekanika molekuler (MM). Daerah MK diperpanjang dan dibagi menjadi daerah inti (*core*) dan daerah *layer*. Metode perhitungan pada tingkat Hartree-Fock (HF) digunakan pada daerah MK, dengan himpunan basis yang digunakan yaitu LANL2DZ-ECP untuk ion Cu<sup>+</sup> dan DZP-Dunning untuk ligan NH<sub>3</sub> dan H<sub>2</sub>O. Validasi metode HF/LANL2DZ-ECP dan DZP-Dunning dilakukan dengan menghitung nilai *basis set superposition error* (BSSE). Sistem kotak simulasi diekuilibrasi pada suhu 298,15 K selama 4 ps. Pengambilan data dilakukan setelah proses ekulibrasi setiap 5 tahapan selama 12 ps. Data trajektori dianalisis lebih lanjut untuk mempelajari solvaci preferensial dan sifat dinamika ion Cu<sup>+</sup> dalam larutan amoniak 18,6%

Hasil analisis trajektori menunjukkan bahwa preferensial ligan NH<sub>3</sub> lebih tinggi dibandingkan H<sub>2</sub>O di kulit solvaci pertama. Hal ini ditandai dengan adanya dominasi 4 ligan NH<sub>3</sub> dan membentuk kompleks stabil [Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sup>+</sup> dengan bentuk geometri tetrahedral. Analisis fungsi distribusi radial menunjukkan probabilitas tertinggi menemukan molekul NH<sub>3</sub> berada pada jarak 2,19 Å. Hasil analisis solvaci preferensial ion Cu<sup>+</sup> di kulit solvaci pertama ini menunjukkan kedekatan data dengan hasil eksperimen. Berbeda dengan NH<sub>3</sub>, ligan H<sub>2</sub>O tidak ditemukan di kulit solvaci pertama. Ligan H<sub>2</sub>O hanya ditemukan di kulit solvaci kedua dengan jumlah yang besar dan sifat labilitasnya tinggi. Waktu tinggal rata-rata (MRT) ligan H<sub>2</sub>O dan NH<sub>3</sub> di kulit solvaci kedua adalah masing-masing sebesar 3,13 ps dan 2,57 ps. Data MRT ini menunjukkan bahwa terdapat proses pertukaran ligan dalam waktu yang sangat cepat.

Kata kunci: larutan amoniak 18,6%, ion Cu<sup>+</sup>, DM-QMCF, preferensial



# PREFERENTIAL SOLVATION AND DYNAMICAL PROPERTIES OF Cu<sup>+</sup> ION IN 18,6% AQUEOUS AMMONIA SOLUTION : AB INITIO QUANTUM MECHANICAL CHARGE FIELD (QMCF) MOLECULAR DYNAMICS STUDY

Wahyu Dita Saputri  
15/391207/PPA/05008

## ABSTRACT

Preferential solvation and dynamical properties of Cu<sup>+</sup> ion have been studied using quantum mechanical charge field molecular dynamics (QMCF-MD) simulation. This study aimed to gain insight into preferential solvation of Cu<sup>+</sup> ion to the NH<sub>3</sub> and H<sub>2</sub>O ligand in a 18.6% aqueous ammonia solution. The QMCF-MD method divides the system into two regions, which were quanum mechanics (QM) and molecular mechanics (MM) region. QM region was extended and devided into core and layer region. Hartree-Fock (HF) level was performed in QM region with LANL2DZ-ECP basis set for Cu<sup>+</sup> ion and DZP-Dunning for NH<sub>3</sub> and H<sub>2</sub>O molecule. Ab initio HF/LANL2DZ-ECP and DZP-Dunning were validated by calculating *basis set superposition error* (BSSE) with MP2 level of theory calculation. Simulation system was equilibrated at 298,15 K for 4 ps. Sampling data was collected every fifth step during simulation time of 12 ps. Simulation trajectories were analyzed further to investigate preferential solvation and dynamical properties of Cu<sup>+</sup> ion in 18,6% aqueous ammonia solution

The trajectory analysis showed the preferential of NH<sub>3</sub> ligand was higher than H<sub>2</sub>O ligand in the first solvation shell. Four NH<sub>3</sub> molecules dominated and formed [Cu(NH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]<sup>+</sup> complex with tetrahedral geometry. The radial distribution function showed the maximum probability of the Cu<sup>+</sup>-NH<sub>3</sub> bond length at 2,19 Å in the first solvation shell. It was different with preferential of H<sub>2</sub>O molecule, H<sub>2</sub>O ligand was not present in the first solvation shell. The large number of H<sub>2</sub>O ligand occupied in the second solvation shell and having high lability. Mean residence time of H<sub>2</sub>O and NH<sub>3</sub> ligand in the second solvation shell were 3,13 ps and 2,57 ps respectively indicating for high intensity of ligand exchange processes.

Keywords: 18,6% ammonia solution, Cu<sup>+</sup> ion, QMCF-MD, preferential